

通信 VCO, 低相噪, 6dBm, 89.5-96.5MHz

特征参数

- 标称调谐频段: 89.5~96.5MHz
- 平均输出功率: ≥6dBm
- 供电电压 (VCC): 5V
- 调谐电压 (VT): 0-9V
- 低相位噪声,低功耗
- 非密封,不可浸泡清洗
- 满足工作温度范围: -40° c~+85° c



产品描述

YSGM909508B是一款高集成度、标准封装尺寸的VC0,采用两级晶体管Cascade结构,工作电流小、输出功率高、隔离度好。此款VC0使用高稳定度振荡电路结构、高精度变容二极管及高输出功率射频三极管,确保起振波形稳定及输出功率较高,对相噪进行了优化处理。系统采用5V标准电压供电。YSGM909508B还集成整流滤波单元及射频输出匹配单元,仅需极少外围元器件且输出功率平坦度好,射频输出端可直接连接50Ω射频线,使用方便。

引脚定义

编号	编码	描述	编号	编码	描述
1	GND	地	8	GND	地
2	VCC	供电电压	9	GND	地
3	GND	地	10	GND	地
4	GND	地	11	GND	地
5	VT	调谐电压	12	GND	地
6	GND	地	13	RFOUT	射频输出
7	GND	地	14	GND	地

Innotion, Inc. All rights reserved. http://www.innotion.com.cn 2023-2-1



通信 VCO,低相噪,6dBm,89.5-96.5MHz

额定标称值

参数	标称值	单位	参数	标称值	単位
调谐电压	0 ~ 9	V	储存温度	−40 [~] +150	° C
供电电压	5	V	相对湿度	<80%	RH
工作温度	−40 [~] +85	° C	大气压力	85 [~] 106	KPa

电气特性(T_A=+25°C, VCC=5V)

₹ ₩	特征值		34 IX	4/#4	
参数	最小	典型	最大	単位	描述
输出频率	89. 5		96. 5	MHz	$T_A=-40^{\circ} \text{ C}^{\sim}+70^{\circ} \text{ C}$
输出功率		6		dBm	$T_A=-40^{\circ} \text{ C}^{\sim}+70^{\circ} \text{ C}$
调谐电压	0		9	$V_{\scriptscriptstyle T}$	T _A =25° C
谐波抑制			-35	dBc	
杂波抑制		-80	-70	dBc	
		-82		dBc/Hz	f _m =1kHz
单边带相位噪声		-114		dBc/Hz	f _m =10kHz
平 2 市 相 位 噪 产		-125		dBc/Hz	fm=100kHz
		-146		dBc/Hz	f _m =1MHz
推频系数			0. 5	MHz/V	
输出端口阻抗		50		Ω	
工作电压		5		V	
工作电流		16		mA	T _A =-40° C~+85° C
工作温度范围	-40		+85	° C	
存储温度范围	-55		+85	° C	

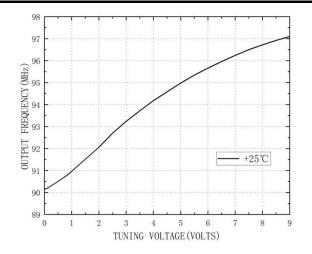
测试曲线

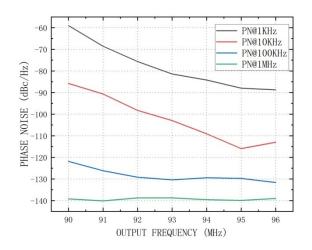
VCO 的调谐特性曲线

VCO 的相噪特性曲线

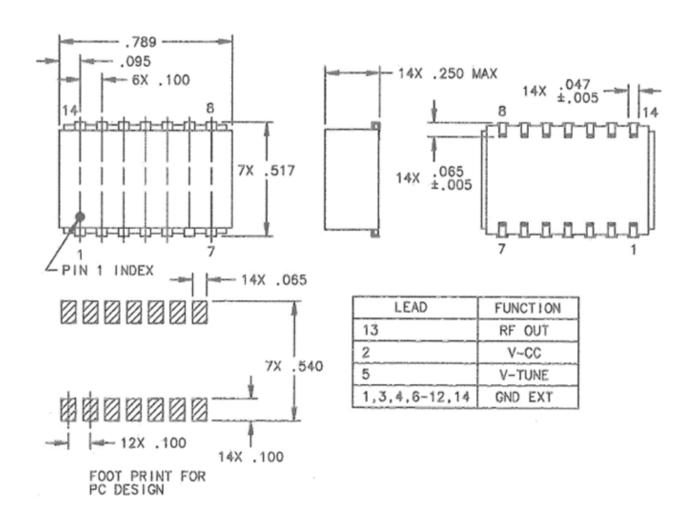


通信 VCO,低相噪,6dBm,89.5-96.5MHz





外形尺寸



UNIT: IN

TOLERANCE: ± 0.015



通信 VCO, 低相噪, 6dBm, 89.5-96.5MHz

注意事项

PCB 板材选择

根据工作频率的不同,可选择不同材料的板材。一般 L 波段以下可选用环氧板, L 波段以上建议选用 微波电路板,如 R04350、R05880等。PCB 板要平整,一般要求翘曲度≤0.75%。PCB 板应有螺钉固定到盒体上,螺钉位置不能离管壳太远,具体位置请结合使用时的振动、冲击强度及电路板厚度综合考虑。

装配方法

VCO 内部器件采用共晶温度 217℃的 SnAgCu 焊料焊接在电路板焊盘上,因此用户进行焊接时应注意控制温度,整个焊接过程中电路板温度不得高于 220℃。

推荐的焊接方法:

- 1) 使安装产品的印制板表面平整;
- 2) 使用 180℃焊锡丝及恒温烙铁焊接,先固定一个引脚;
- 3) 按焊对角顺序焊接所有引线,直至焊接结束;
- 4) 电源端,电调端及输出端口焊接温度 280℃,接地端 350℃(温度仅供参考,根据实际情况,以 保证电路板温度不得高于 220℃为前提);
- 5) 引线侧面焊锡量应适量,尽量避免焊锡越过侧壁附着到管帽上。
- 6) 焊接过程中使用松香助焊时,松香用量应适中,焊接完成后用适量的酒精棉球擦除松香等多余物, 不得使酒精、松香进入产品内部,不得将整只产品浸入清洗液等清洗环境清洗。

注意事项

● 可靠性

VCO 产品采用 PCB 电路板及金属帽的非密封形式,内部使用塑封器件,其固有质量等级较低,且对焊接敏感,因此用户电路板难以维修或可靠性要求较高的项目不建议使用,建议使用密封产品。

● 接地

产品应良好接地,射频地与数字地应相互隔离,为保证微波性能,还应就近接地。如接地不良,可能导致振荡器停振、自激,使用时请注意。

● 负载

VCO 产品内部设计有缓冲隔离放大器,使用时尽可能在 VCO 产品之后加入衰减、放大电路进行隔离,以避免产生负载牵引,导致故障。

● 电源滤波/去耦

表贴介质压控振荡器产品内部电源滤波电路相对简单,因此需要用户针对自身使用环境进行适当的电源滤波。推荐采用线性稳压电源供电,并进行良好的滤波,一般建议采用 10uF 以上的钽电容和 nF、pF 级的低 ESR 瓷介电容滤波,如相位噪声仍不能达到要求,可在滤波电容前加一个小电阻($3\Omega\sim5\Omega$ 左右)以实现 RC 滤波,这样效果较好,但这需要在产品制作前提出,以降低产品的工作电压,留出电阻降压的余量。一般而言压控振荡器对电源最为敏感,应仔细考虑系统电源上可能存在的杂散,并有针对性的采取措施。

● 储存

对于需长期储存(超过半年)产品尽量在充氮干燥环境下存放,湿度不要超过60%。